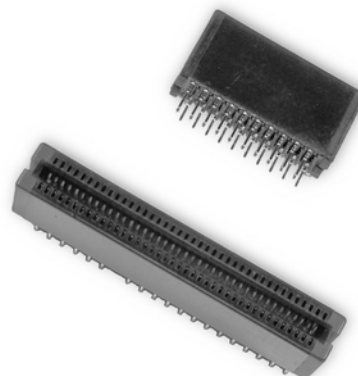


Card Edge Verbinder RM 1,27mm - Single Slot Version Card Edge Connectors, 1.27mm Pitch - Single Slot Version

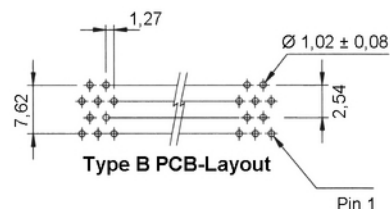
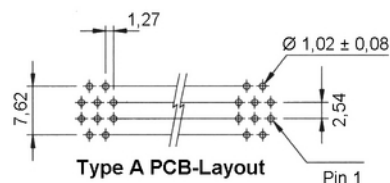
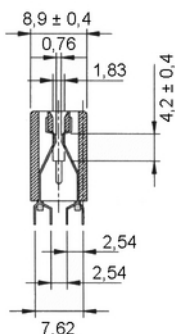
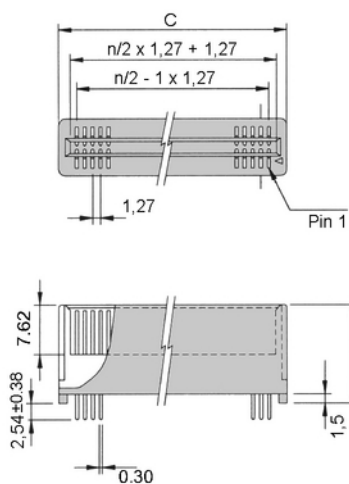
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Farbe <i>Colour</i>	Schwarz <i>Black</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Steckbereich vergoldet / Lötseite verzinkt (andere Veredelungen auf Anfrage) <i>Gold plated mating area / tin plated solder area</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 30mΩ <i>< 30mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>> 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{AC} <i>500V_{AC}</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	125V _{AC} max. <i>125V_{AC} max.</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A <i>1A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +105°C <i>-55°C ... +105°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>
Mechanische Haltbarkeit <i>Mechanical Durability</i>	Min. 100 Steckzyklen <i>Min. 100 cycles</i>



© W+P PRODUCTS

Empfohlene Steckkartendicke:
1,60mm+/-0,30
Recommended Thickness of PCB:
1.60mm+/-0.30



Series

121

Contacts*

080

- 010 C=10,80mm
- 012 C=12,07mm
- 020 C=17,15mm
- 030 C=23,50mm
- 040 C=29,85mm
- 050 C=36,20mm
- 060 C=42,55mm
- 080 C=55,25mm
- 100 C=67,95mm
- 120 C=80,65mm

Type*

10

- 10 Type A
- 20 Type B

Plating

60

- 60 Sel. Au/Sn
- Duplex plating

Auf Anfrage auch mit Befestigungsflansch lieferbar.
Also available with mounting ears.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
WEBSITE www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min



Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

Recommended wave soldering profile:

